

镇江晶圆 晶森半导体 清洗机 晶圆腐蚀

产品名称	镇江晶圆 晶森半导体 清洗机 晶圆腐蚀
公司名称	苏州晶森半导体设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区金海路34号
联系电话	13771786452 13771786452

产品详情

MEMS是将微电子技术与机械工程融合到一起的一种工业技术，它的操作范围在微米范围内；微机电系统有多种原材料和制造技术，而硅则是用来制造微机电系统的主要原材料，微机电系统的生产方式是在基质上堆积物质层，然后使用平板印刷和蚀刻的方法来让它形成各种需要的结构。

化学清洗槽（也叫酸槽/化学槽），主要有HF，H₂SO₄，H₂O₂，HCL等酸碱液体按一定比例配置，目的是为了去除杂质，去离子，去原子，后还有DI清洗。IPA是，就是工业酒精，是用来clean机台或parts的，是为了减少partical的。

无机类异物清洗主要用水冲洗，但是水往往是以不同压力及形式冲洗在玻璃基板的表面。

HPMJ—High Pressure Micro Jet，高压微粒喷射清洗技术，晶圆酸洗，通过对水增压，在喷嘴处以高压水微粒形式，喷射在玻璃基板表面，镇江晶圆，达到去除表面大颗粒异物的目的。有些制程特性的需求，也可以和二氧化碳一起混合加入，形成二氧化碳水，即碳酸，让水可以导电，达到可以去除静电的目的。AAJET—Aqua Air Jet，晶圆腐蚀机，水气二流体清洗技术。这种技术是把水和空气在一定的压力下，按照一定的比例从喷嘴中喷出。其中喷嘴的形式，有单个喷出扇形模式，也要直接采用Slit Nozzle模式，晶圆腐蚀，即喷出为水幕。第二种喷出形式在玻璃基板表面形成的压力较为均匀，不会对产品产生不良。Roller Brush-

旋转毛刷清洗技术，利用高速旋转的毛刷并增加适当的压入量，达到清洁玻璃表面异物的目的。

超声波清洗机酿造/制药工业：

需要清洗的产品：瓶、盖子、标签去除装置、排气装置、处理器皿、处理用器具、充填装置管道等

污染源：残剩食物、指纹、灰尘、线头、淀粉、染料、蛋白印刷(烘烤前)油、润滑油、硅油

使用清洗剂：碱性洗涤剂、酸性洗涤剂、中性洗涤剂；有机洗涤剂；纯水

清洗设备是指可用于替代人工来清洁工件表面油、蜡、尘、氧化层等污渍与污迹的机械设备。目前市面上所见到清洗设备为：超声波清洗、高压喷淋清洗、激光清洗、蒸汽清洗、干冰清洗及复合型清洗设备等；

镇江晶圆-晶淼半导体 清洗机-晶圆腐蚀由苏州晶淼半导体设备有限公司提供。苏州晶淼半导体设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州晶淼半导体——您可信赖的朋友，公司地址：苏州工业园区金海路34号，联系人：王经理。